



**Ideal geeignet für Doppelspur-
betrieb und hohen Durchsatz**

**Bewährtes Viscom-Maschinen-
konzept für verschiedenste
Anwendungen**

**Sehr gute Eignung für
große Prüflinge**

**Leistungsfähige Inspektions-
software von Viscom**

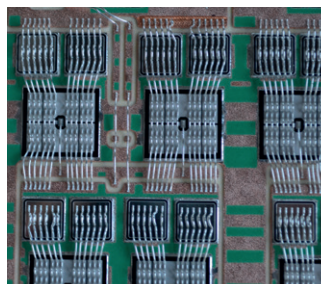
**Besonders hohe Genauigkeit
und Prüftiefe**

Leistungsstarke automatische Drahtbondinspektion

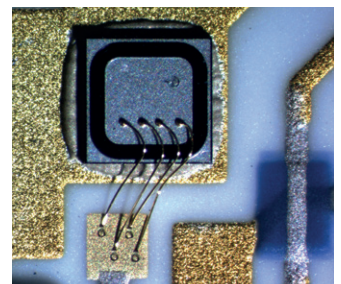
Mit dem Inspektionssystem S6056BO bietet Viscom beste Inline-Technik und maximale Leistung für die automatische optische Inspektion von Drahtbonds. Um die Prüfzeiten deutlich zu reduzieren, kann bei hohen Durchsatzanforderungen ein Doppelspurbetrieb realisiert werden. Das System ist besonders leicht über die Standards hinausgehend kundenspezifisch konfigurierbar. Auch große Prüflinge lassen sich dann sicher und effektiv kontrollieren.

Die hochgenaue Inspektion garantiert eine zuverlässige Fehlererkennung bei Bändchen, Die-, Ball-Wedge-, Wedge-Wedge- und Security-Bonds. Der Prüfumfang lässt sich über die Standardfehler hinaus für weitere Applikationen individuell anpassen. Auch Beschädigungen und Lageabweichungen von Bauelementen können sicher detektiert werden. Die leistungsfähige Viscom-Inspektionssoftware nimmt die kombinierte Prüfung von Drahtbonds und SMD-Bestückung vor. Mit der hohen Auflösung werden sämtliche Bondstellen und -drähte erfasst. Zum Inspektionsumfang gehören u. a. Drahtverläufe, Dies und Bauteillagen. Dabei ist es unerheblich, ob die Verbindungen aus Kupfer, Aluminium oder Gold bestehen und ob es sich um Bändchen, Dickdraht oder Dünndraht handelt.

Auf Basis der leistungsfähigen Viscom-SPC-Auswertung lassen sich vielfältige Rückschlüsse auf den Prozess ziehen. Das führt zu einer Verringerung der Fehlerquellen und erhöht die Fertigungsqualität. Remote-Diagnosen, weltweite Wartung und eine Service-Hotline runden das Angebot ab.

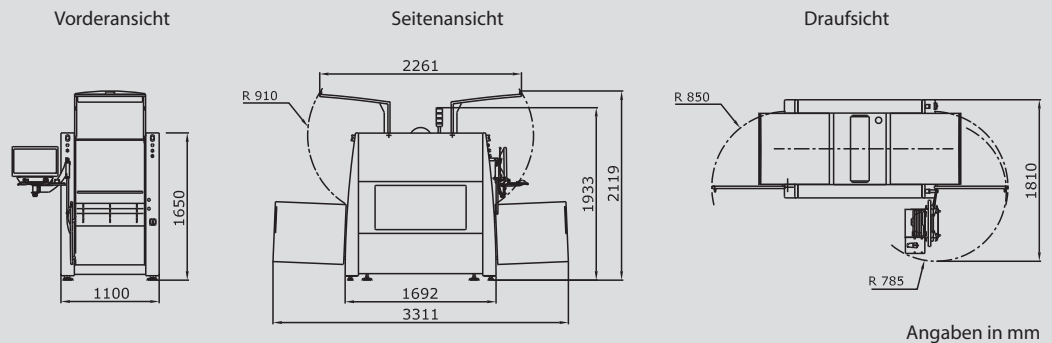


Fehlererkennung an Multidraht-
verbindungen und Mehrfachloops



Verbogene Drähte

Technische Daten



		S6056BO		
	Transportsystem	Einzelspur	Doppelspur	Doppel-Shuttle
	Prüfkonzept	Einzelprüfung		
Inspektionsumfang	Bond	Ball-Bond, Wedge-Bond, Draht, Die/SMD, Bändchen		
Sensorik	Standardkonfiguration XM Bond HR*			
	Anzahl der Module pro Maschine	1		
	Anzahl Kameras	1		
	Bildpunktgröße	4,5 µm/Pixel		
Software	Bedienoberfläche	Viscom EasyPro		
	SPC	Viscom SPC (statistische Prozesskontrolle), offene Schnittstelle (optional)		
	Verifikationsplatz	Viscom HARAN		
	Remote-Diagnose	Viscom SRC (Software Remote Control) (optional)		
	Programmierplatz	Viscom PST34 (optional)		
Systemrechner	Betriebssystem	Windows®		
	Prozessor	Intel® Core™ i7		
Substrathandling	Max. Substratgröße	300 mm x 400 mm (L x B)*	290 mm x 200 mm (L x B)*	
	Übergabehöhe	860 - 1180 mm ± 20 mm		
	Substratfixierung	Vakuum oder mechanische Klemmung		
	Obere Durchfahrtshöhe	Bis zu 35 mm		
Prüfgeschwindigkeit		Bis zu 65 cm ² /s, minimierte Handlingzeit		
Sonstige Systemdaten	Verfahr-/Positioniereinheit	Synchron-Linearmotoren		
	Schnittstellen	SMEMA, SV70, kundenspezifisch		
	Anschlusswerte	400 V (andere Spannungen auf Anfrage), 3P/N/PE, 8 A, 4 - 6 bar Arbeitsdruck		
	Systemmaße	1100 mm x 1650 mm x 1692 mm (B x H x T)		
	Gewicht	1700 kg		

*Weitere Sensoriken und Substratgrößen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten. Windows® und Intel® Core™ i7 sind eingetragene Warenzeichen.

#Viscom_S6056BO_DE19100004